

LEPSTYR-W 230

Zaprawa klejąca do mocowania płyt z wełny mineralnej

Charakterystyka:

Zaprawa do mocowania płyt z wełny mineralnej przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiw i wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejącą barwy szarej. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o dobrej przyczepności do podłoża i płyt z wełny mineralnej.

Przeznaczenie:

Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płyt izolacyjnych z wełny mineralnej do zewnętrznych ścian budynków ocieplanych systemami TURBO-W, TURBO-WSA, TURBO-WSO i TURBO-WSISI firmy KREISEL. Podłożami do przyklejania płyt izolacyjnych mogą być m.in.: betony zwykłe, mury z elementów ceramicznych, silikatowych, betonowych, z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych - o powierzchniach surowych, otynkowanych lub z powłokami malarskimi względnie fakturowymi. Płyty izolacyjne przyklejone zaprawą LEPSTYR-W 230 wymagają dodatkowego mocowania kołkami rozprężnymi. Do wykonywania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną należy zastosować zaprawę klejowo-szpachlową STYRLEP-W 240 lub STYRLEP-B 225 firmy KREISEL.

Dane techniczne:

Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące
Gęstość objętościowa: ok. 1,70 g/cm³
Przyczepność do betonu w stanie powietrzno –suchym: ≥ 0,3 MPa
Przyczepność do betonu po cyklach termiczno wilgotnościowych: ≥ 0,3 MPa
Przyczepność do wełny lamelowej: ≥ 0,1 MPa
Przyczepność do wełny zwykłej: ≥ 0,015 MPa
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogólną suchą masę wyrobu: ≤ 0,0002%

Dane wykonawcze:

Środek gruntujący podłoże: GRUNTOLIT-W 301
Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C
Proporcje mieszania z wodą: ok. 6,3 litrów na 25 kg suchej mieszanki
Czas przydatności po zarobieniu wodą: ok. 2 godziny (w temperaturze otoczenia +20°C)
Zużycie: ok. 5-6 kg/m²

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża: Podłoże do przyklejania płyt izolacyjnych musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy (np. kurzu, pyłu, olejów, środków antyadhezyjnych, mchu) i wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw. Krucho i odpadające tynki należy usunąć. Powierzchnię ściany, otynkowaną lub nieotynkowaną, w zależności od potrzeb należy oczyścić mechanicznie (np. szczotkami drucianymi), zmyć wodą z hydrantu i odczekać aż wyschnie. Przy nierównościach podłoża większych niż ± 1cm oczyszczone podłoże należy wyrównać zaprawą szpachlowo-renowacyjną RENOBUD 429. Miejsca, w których został usunięty tynk słabo związany z podłożem, wypełnić zaprawą tynkarską POZTYNK 560. Podłoża silnie nasiąkliwe oraz podłoża

piaszczące należy zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301.

Przygotowanie produktu: Suchą mieszankę należy wysypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielanie składników. Stwardniałej masy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym materiałem.

Sposób stosowania: Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych. Przy klejeniu płyt do podłoża równych można stosować metodę płaszczyznową nakładania kleju. Na płytę należy nanieść porcję zaprawy klejącej i wykorzystując prostą krawędź kielni rozprowadzić cienką warstwą, dociskając do powierzchni płyty. Następnie należy nanieść dodatkową porcję zaprawy i rozprowadzić ją ząbkowaną krawędzią kielni (co najmniej 10 x 10 x 10 mm). Przy podłożach nierównych zaprawę klejącą należy nakładać metodą pasmowo-punktową. Wzdłuż krawędzi płyty zaprawę nanosić pasmami o szerokości 3-4 cm, uformowanymi w kształcie przyzmy. Na pozostałej powierzchni płyty układać 3-6 placków zaprawy o średnicy 10-15cm. Wysokość naniesionych porcji zaprawy powinna być mniej więcej taka sama, aby uzyskać przyklejenie płyty zarówno na obwodzie jak i w części środkowej. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą płaszczyznę z sąsiednimi płytami. Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wyciśniętej zaprawy klejącej należy usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne jej resztki. Płyty izolacyjne muszą być przyklejone do podłoża co najmniej 40% swej powierzchni. Do prowadzenia dalszych prac, tj.: wyrównania i oczyszczenia powierzchni płyt, dodatkowego mocowania kołkami rozprężnymi, wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną przy użyciu zaprawy STYRLEP-W 240 lub STYRLEP-B 225, można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejania płyt izolacyjnych. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Uwaga! Należy stosować pełen zestaw wyrobów systemu ociepleń.

Czyszczenie narzędzi:

Czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Opakowania:

Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk.

Przechowywanie:

Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

Ostrzeżenie:

Produkt po zarobieniu wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

LEPSTYR-W 230

Zaprawa klejąca do mocowania płyt z wełny mineralnej

Dokument odniesienia:

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0118

Data aktualizacji:

07/2008